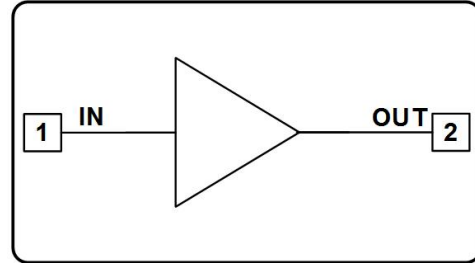




主要特点

- 工作频段: 0.005-4 GHz
- 增益: 20 dB
- 噪声系数: 2.0 dB
- 直流供电: 5V/50 mA
- 反向隔离: 27 dB
- P1dB: +20 dBm
- 芯片尺寸: 1.0×0.82×0.1 mm³

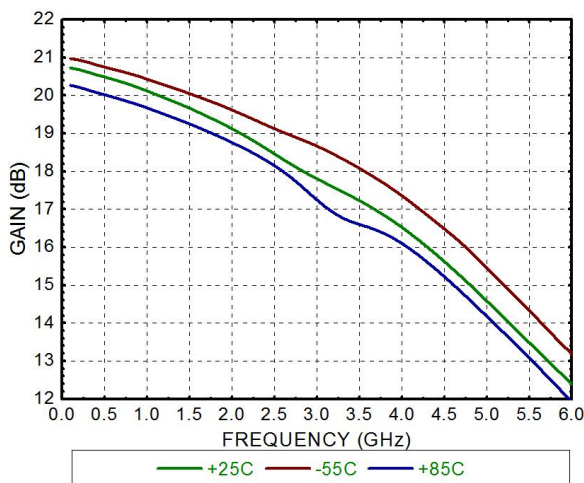
功能框图



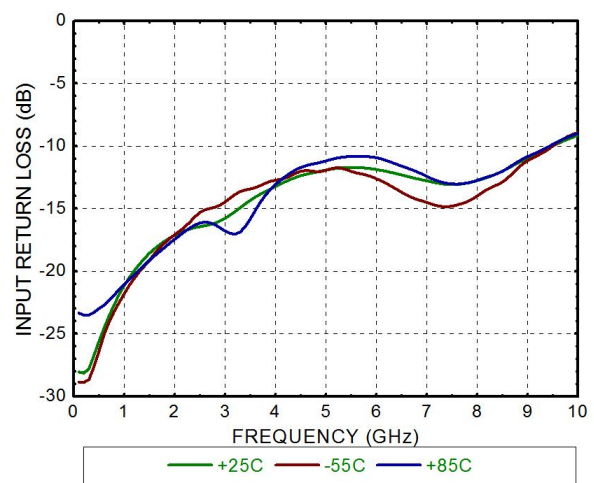
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, 5V/50mA)

参数	最小	典型	最大	单位
工作频段	0.005 - 4			GHz
增益		20		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		12		dB
反向隔离度		27		dB
输出功率 1dB 压缩点		20		dBm
噪声系数		2.0		dB
OIP3		31		dBm
工作电流	30	50	80	mA

增益

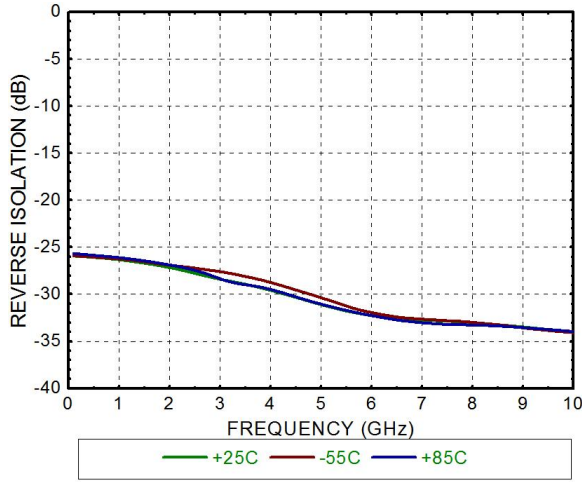


输入回波损耗

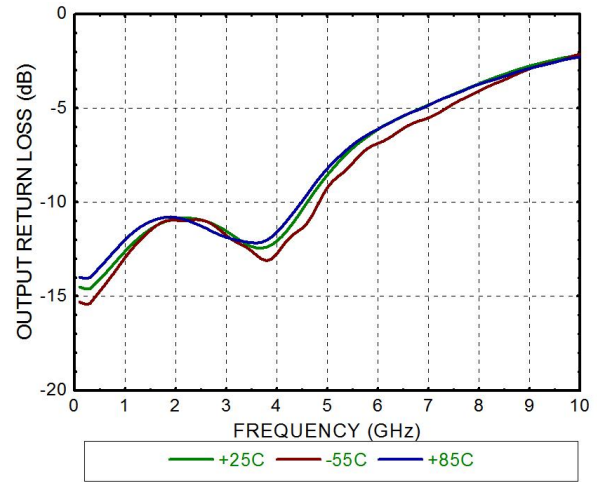




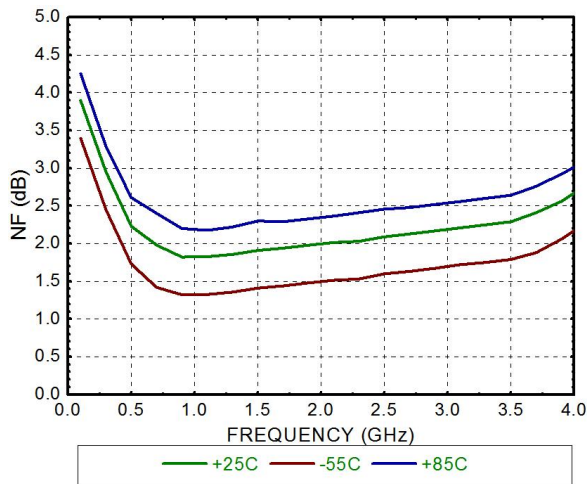
反向隔离



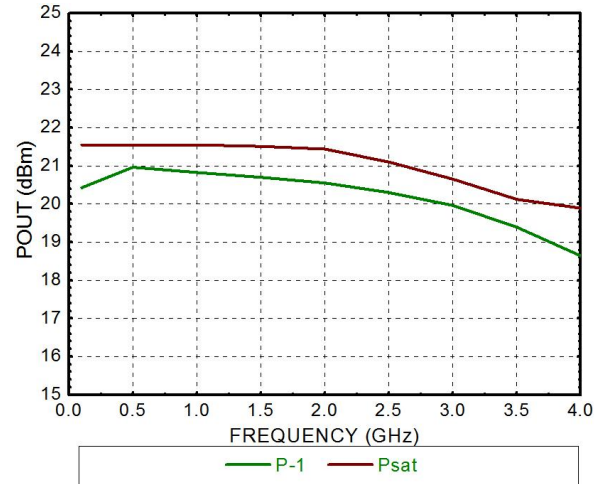
输出回波损耗



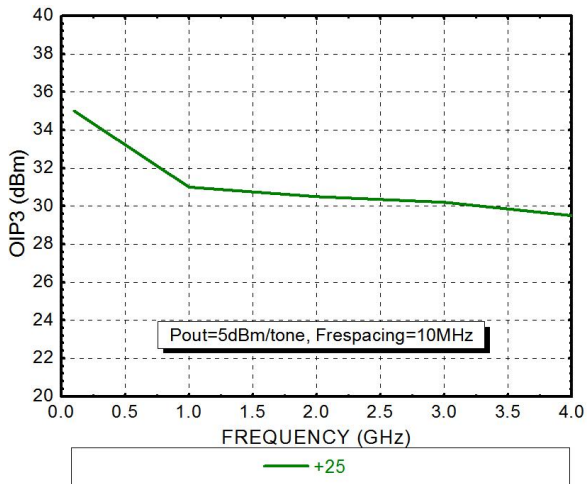
噪声系数



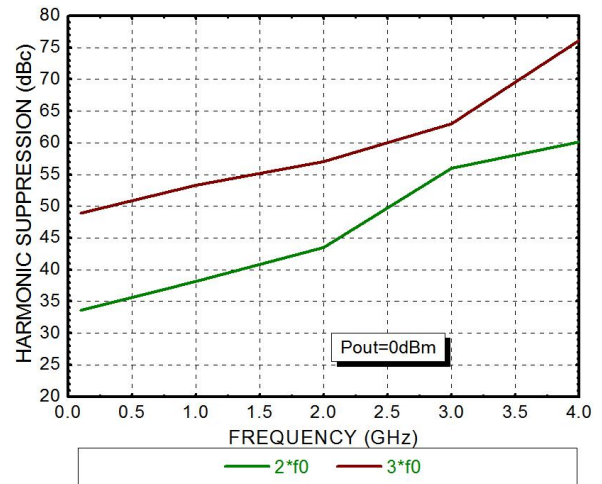
输出功率



OIP3

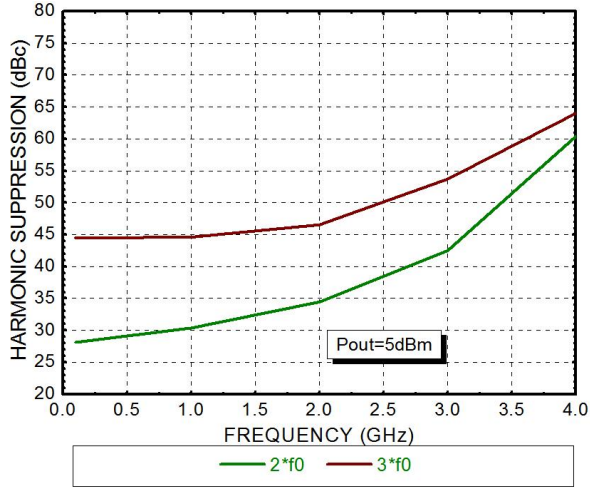


谐波抑制



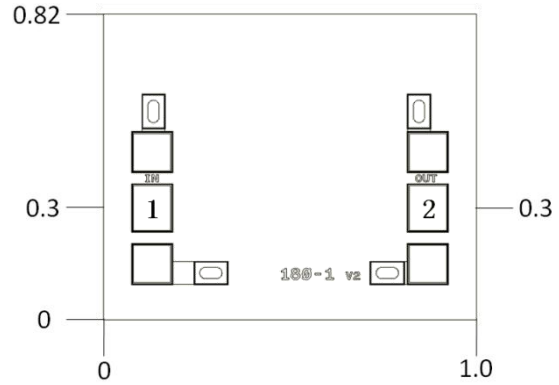


谐波抑制



物理参数

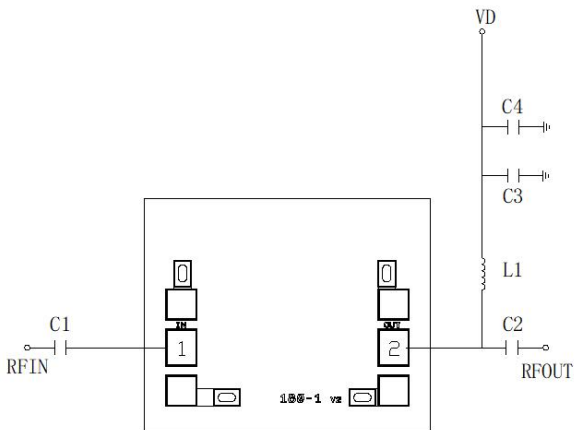
单位: mm



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm
2	OUT	该焊盘是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

推荐偏置电路



频率	30MHz	100MHz	1GHz	2GHz
L1(nH)	820	270	47	22
C1/C2(pF)	1000	200	20	10
C3/C4(uF)	0.001/0.01			

极限参数

射频输入功率: +18dBm

储存温度: -65~+150°C

输出端口供电: +6V

工作温度: -55~+85°C